

# 天津中环半导体股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“中环股份”或“本公司”），编制了截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1293号文核准，由主承销商平安证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）247,770,069股，每股发行价格为20.18元/股。至2020年7月23日，公司实际收到非公开发行人民币普通股（A股）247,770,069股，募集资金总额4,999,999,992.42元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币86,510,380.33元后，实际募集资金净额为人民币4,913,489,612.09元。其中，计入注册资本人民币247,770,069.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币4,665,719,543.09元。上述募集资金于2020年7月23日到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了CAC证验字[2020]0141号验资报告。

#### （二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首先由项目负责部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过总经理授权范围的，应报董事会审批。公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

#### （三）募集资金专户存储情况

公司按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。

公司于2019年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了平安银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：15000101715706；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：77010078801000002948，用于中环股份“集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用；中国光大银行股份有限公司无锡分行专项账户，其活期存款账户为：39920180809650015，用于中环领先“集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目”募集资金的存储和使用。截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额如下：

单位：元

序号	开户人	银行名称	账号	余额
1	中环股份	平安银行股份有限公司天津分行	15000101715706	66,757.27
2	中环股份	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010078801000002948	53,594,500.44
3	中环领先	中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180809650015	56,791,853.28
合计				<b>110,453,110.99</b>

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日止，公司2019年非公开发行股票募集资金实际使用情况，详见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更

本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2020年7月23日公司召开了第五届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金211,091.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了CAC证专字[2020]0458号《募集资金置换鉴证报告》。保荐机构平安证券股份有限公司同意中环股份本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

截至2020年12月31日，公司累计实际以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为211,091.00万元。

(四) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

前次募集资金的实际投资与承诺投资总额一致。

(五) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2020年12月31日，公司不存在对上述项目对外转让或置换的情况。

(六) 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

2020年7月23日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目按进度实施的前提下，使用不超过180,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金项目按进度实施的前提下，使用最高额不超过200,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2020年12月31日，部分闲置募集资金180,000.00万元暂时补充流动资金，部分闲置募集资金29,500.00万元进行现金管理，其余11,045.31万元（含利息收入）存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2020年12月31日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况，详见本报告附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### 四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规行为。

附表一：《募集资金使用情况对照表》

附表二：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021年4月26日

附表一：募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		500,000.00				本年度投入募 集资金总额	271,572.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募 集资金总额	271,572.86			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生 产线项目	否	450,000.00	450,000.00	230,223.90	230,223.90	51.16%	2021 年 10 月	10,327.97	不适用	否
补充流动资金	否	50,000.00	41,348.96	41,348.96	41,348.96	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	500,000.00	491,348.96	271,572.86	271,572.86	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换金额为 211,091.00 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2020 年 7 月 23 日第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用不超过 180,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意使用闲置募集资金最高额不超过 200,000.00 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 日，部分闲置募集资金 180,000.00 万元暂时补充流动资金，部分闲置募集资金 29,500.00 万元进行现金管理，其余 11,045.31 万元（含利息收入）存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表二：募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止 2020 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预期效益
序号	项目名称		2018 年	2019 年	2020 年		
1	集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目	达产年平均净利润 63,156.89 万元	不适用	不适用	10,327.97 注	10,327.97	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：“集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目” 2020 年度开始投产，目前尚在建设期，尚未完全达产。